

スマートプロセス学会誌

目次 Vol. 7 No. 4 2018 (平成 30 年 7 月)

Mate2018 特集号 - 第24回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」シンポジウム -

追悼	
会告 N10
巻頭言	Mate2018 特集号によせて 西川 宏..... 121
研究論文	過渡熱解析による 3 次元積層 IC 内のアンダーフィル層の熱抵抗の評価 佐々木真・菊池 遼・酒井泰治・作山誠樹..... 122
	高温高湿環境下における銅 / エポキシ樹脂界面の劣化寿命評価 戸野塚悠・小林竜也・荘司郁夫 外蘭洋昭・高橋邦明・江連 徳..... 128
	難めっき材へのシリコンオリゴマーを用いたメタライズ法及び オリゴマー皮膜特性の確認 佐土原大祐・松本守治・清野正三..... 135
	大電流用プレスフィット接続部における界面状態と接触安定性に関する 検討 江草 稔・石橋秀俊・大坪義貴・菊池正雄・加柴良裕..... 139
	パワーモジュールにおける熱サイクル試験時の封止樹脂のはく離予測評価 川下隼介・七藏司優斗・池田 徹 小金丸正明・外蘭洋昭・浅井竜彦..... 146
	Ag 添加 InSn 合金における凝固過程の変化と組織への影響 上村泰紀・野村健二・酒井泰治・作山誠樹..... 154
	Material and Process for Insulation Reliable Circuitry below 2/2 μm Line/Space Kazuyuki MITSUKURA, Shinichiro ABE, Masaya TOBA Kenichi IWASHITA, Tomonori MINEGISHI Kazuhiko KURAFUCHI and Kozo FUJIMOTO..... 160
報告記事	エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術シンポジウム (Mate2018) 開催報告 松嶋道也..... 166
会報・掲示板 N16

Journal of Smart Processing

Vol. 7 No. 4 2018 (July 2018)

CONTENTS

Mate2018 特集号 - 第24回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」シンポジウム -

Memorial

S.P.S. Announcement N10

Preface..... Hiroshi NISHIKAWA..... 121

Research Papers

Evaluation of Thermal Resistance for Underfill Layer in
Three-dimensional Stacked ICs by Transient Thermal Analysis
Makoto SASAKI, Ryo KIKUCHI, Taiji SAKAI and Seiki SAKUYAMA..... 122

Evaluation of Deterioration Life of Interface of Copper and Epoxy Resin
under High Temperature and High Humidity Conditions
Yu TONOZUKA, Tatsuya KOBAYASHI, Ikuo SHOHJI,
Hiroaki HOKAZONO, Kuniaki TAKAHASHI and Toku EZURE..... 128

Metallization Method using Silicone Oligomer on Hard-to-plate
Materials and Characterization of Oligomer Film
Daisuke SADOHARA, Moriji MATSUMOTO and Shozo SEINO..... 135

Interface Reaction and Contact Stability of High-Current Press-fit Connection
Minoru EGUSA, Hidetoshi ISHIBASHI, Yoshitaka OTSUBO
Masao KIKUCHI and Yoshihiro KASHIBA..... 139

Evaluation of the Delimitation of Molding Resin in a Power Module under Thermal Cycle Test
Shunsuke KAWASHITA, Yuto NANAZOSHI, Toru IKEDA
Masaaki KOGANEMARU, Hiroaki HOKAZONO and Tatsuhiko ASAI..... 146

Effects of Ag Addition on Solidification Process and Microstructure of InSn Alloy
Taiki UEMURA, Kenji NOMURA, Taiji SAKAI and Seiki SAKUYAMA..... 154

Material and Process for Insulation Reliable Circuitry below 2/2 μm Line/Space
Kazuyuki MITSUKURA, Shinichiro ABE, Masaya TOBA
Kenichi IWASHITA, Tomonori MINEGISHI
Kazuhiko KURAFUCHI and Kozo FUJIMOTO..... 160

Special Report for Mate 2018

Report on 24th Symposium on “Microjoining and Assembly Technology in Electronics”
Michiya MATSUSHIMA..... 166

S.P.S. News N16